

深圳市光明区人民政府文件

深光府规〔2023〕7号

深圳市光明区人民政府印发《深圳市光明区 关于支持智能传感器产业集群高质量 发展的若干措施》的通知

各有关单位：

现将《深圳市光明区关于支持智能传感器产业集群高质量发展的若干措施》印发给你们，请遵照执行。执行过程中遇到的问题，请径向相应的职能部门反映。

深圳市光明区人民政府
2023年3月25日

深圳市光明区关于支持智能传感器产业集群高质量发展的若干措施

第一章 总则

第一条 为贯彻落实《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（国发〔2020〕8号）、《深圳市人民政府办公厅印发关于加快集成电路产业发展若干措施的通知》（深府办规〔2019〕4号）、《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》（粤府函〔2020〕82号）、《深圳市人民政府印发关于推动制造业高质量发展坚定不移打造制造强市若干措施的通知》（深府规〔2021〕1号）、《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》（深府〔2022〕1号）、《深圳市培育发展智能传感器产业集群行动计划（2022—2025年）》等文件精神，促进光明区智能传感器产业高质量发展，加快建设智能传感器中试熟化与产业化示范区，特制定本措施。

第二条 本措施适用于已登记注册，具备独立法人资格，从事智能传感器研发、生产和服务的企业，以及其他事业单位、社会团体、民办非企业等机构。

第三条 本措施重点推动中试平台、封测平台等公共服务平台建设，着重提升智能传感器创新产品研发能力，重点聚焦消费

电子、智能驾驶、智能机器人、工业控制等应用领域发展基于 MEMS 工艺的智能传感器产品，并对承担国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部等部委开展的集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划项目予以支持。

第二章 推动重大项目落地

第四条 支持建设智能传感器 MEMS 中试线。支持引进国内外一流 MEMS 晶圆制造产线建设运营机构，在光明区建设一条兼具研发中试和量产能力的亚微米级 8 英寸 MEMS 中试线，重点推动深硅刻蚀、薄膜沉积、薄膜应力控制等核心制造工艺升级，形成标准工艺设计工具包（PDK），面向市内外有关企业提供研发中试和批量代工服务。对项目涉及的相关主体采取“一事一议”方式予以支持。

第五条 支持建设 MEMS 先进封测公共服务平台。依托 MEMS 中试平台，鼓励国家级 MEMS 封测龙头企业建设智能传感器先进封测服务平台，鼓励区内相关企业利用自有封测产线承接封测服务平台服务需求，共同为企业 提供封装方案设计与仿真、封装组装、测试包装等工艺定制化开发和产品封装代工服务，满足不同类别、不同原理的传感器测试需求。对建设先进封测服务平台，按照项目实际投资的 40%，给予最高不超过 1000 万元补贴。对企业将自建封测线对外开放，配合区级智能传感器先进封测服务平台承接封测服务的，按服务合同额的 10%，给予每年最高 200

万元补贴。

第六条 支持建设技术协同平台。鼓励建设数字化、国际化、标准化的技术协同平台，提供案例发布、供需对接、技术交流等创新体验，推动实现消费电子、汽车电子、智能制造等应用领域与智能传感器技术产品双向匹配。遴选世界领先的智能传感器技术协同平台，对入选平台分 3 期给予建设补贴，最高补贴 1000 万元。支持区内企业上平台开拓市场，提升国际知名度和影响力，对使用区级智能传感器技术协同平台服务的企业，按照平台当年度收取服务费用的 50% 给予一次性补贴，最高补贴 20 万元。

第七条 开展精准靶向招商。设立规模不少于 50 亿元人民币的智能传感器产业发展基金，开展股权投资，强化招商引资。瞄准智能传感器行业领军企业，引进国际领先的消费、汽车、工业智能传感器整合元件制造商（IDM）落地。对经认定的重大项目落地建设予以支持，按项目实际投资额的 20%，给予最高不超过 5000 万元奖励。

第三章 提升产业创新能级

第八条 支持企业首轮流片。支持智能传感器企业开展高端智能传感器首轮流片，按照工程产品首轮流片费用（含 IP 授权或购置、掩模版制作、流片等）的 30% 给予补贴，单个企业年度最高补贴不超过 300 万元。鼓励企业利用光明区 MEMS 中试平台流片，按首次流片费用的 60% 给予补贴，单个企业年度最高补贴

不超过 600 万元。

第九条 开展关键核心技术攻关。支持智能传感器相关企业或机构开展新型消费电子、智能驾驶汽车、智能机器人、工业互联网、工业控制等领域的中高端智能传感器及智能硬件高端通用器件、关键设备、核心材料、先进工艺等技术研发和产品攻关，支持相关企业与国内顶尖科研机构合作提出自有专利技术。对国家、省、市立项的关键核心技术攻关项目，或国家、省、市级技术研发机构，在光明区建设落地的，最高按市级支持金额的 50% 予以配套奖励，最高不超过 1000 万元。

第四章 支持企业做大做强

第十条 支持企业并购重组。重点支持本地智能传感器芯片设计企业、系统集成厂商、仪器仪表厂商等企业兼并收购国内外智能传感器上下游企业，光明区政府投资引导基金可共同出资参与或提供资金支持。对成功并购国内外智能传感器领域上下游知名企业或研发机构且在光明区建设落地的，按并购金额的 10% 给予奖励，单个并购项目最高奖励不超过 1000 万元。

第十一条 支持建设先进封测产线。聚焦硅通孔技术 (TSV)、3D 集成封装等先进封装技术研发和产业化需求，重点支持国内外智能传感器龙头骨干企业在光明区建设先进封装量产线，按照固定资产实际投入的 10% 给予补贴，单家企业累计补贴最高不超过 1000 万元。

第十二条 鼓励智能传感器专业园区建设。支持通过完善生产厂房、办公用房、原材料仓库、大宗气站等配套基础设施，并通过向入园企业提供配套公共服务等方式，打造智能传感器专业园区。对符合条件的企业入驻经区产业部门认定的产业用房，予以最高 20 元/平方米/月的租金补贴（对入驻“工业上楼”园区的补贴政策另行制定），单个企业年度最高补贴不超过 200 万元。

第五章 加快重点行业示范应用

第十三条 加快新型智能传感器产业化进程。鼓励面向新型消费电子、汽车电子、工业控制等领域开展新型智能传感器研发和产业化。对率先在全球实现产业化应用，或率先突破国外垄断的智能传感器产业化项目，按项目实际投资 20%的比例给予一次性奖励，最高不超过 500 万元奖励；对采购该类智能传感器产品的，按首年度采购金额的 10%，单种产品最高不超过 500 万元奖励，单家企业累计不超过 1000 万元奖励。

第十四条 加快智能传感器应用推广。制定区级智能传感器产品目录，鼓励市场主体加大产品研发与制造。通过双向奖励方式，鼓励智能传感器企业在消费电子、汽车电子、智能制造、物联网、工业自动化等领域进行产品应用推广。对于企业销售自主研发设计的智能传感器芯片或模组产品，且企业年度销售金额累计超过 500 万元的，按年度销售金额增量的 20%，给予最高 500 万元奖励；对于企业采购此类产品，且年度采购金额累计超过

500 万元的，按年度采购金额增量的 20%，给予最高 500 万元奖励。

第十五条 推动制定国际通用的传感器标准。鼓励企业参与制定国际通用的传感器标准。对主导制定国际、国家、行业、团体标准的传感器相关企业或机构，分别一次性给予 100 万元、50 万元、20 万元和 10 万元的奖励。

第十六条 打造智能传感器产业良好发展氛围。打造全球知名峰会品牌，加强智能传感器领域全球人才、技术、项目等交流与合作。对举办经区政府备案的专业性产业峰会、重大论坛等活动的机构，按实际发生额的 50%，给予最高不超过 200 万元奖励。

第六章 附则

第十七条 在符合《深圳市人民政府办公厅关于印发加快集成电路产业发展若干措施的通知》（深府办规〔2019〕4 号）等文件的前提下，对承担国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部等部委开展的集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划项目，在重大项目落地建设、关键核心技术攻关等方面可参照本措施相关条款实施。

第十八条 本措施原则上同市级以上政策可叠加享受，与光明区其它同类优惠措施由企业按照就高不就低的原则选择适用，不重复补贴，所需资金从光明区经济发展专项资金中列支，并纳入区经济发展专项资金管理办法进行管理，有数量和额度限制，

受区经济发展专项资金年度总额控制，具体以当年发布的申请指南为准。

第十九条 本措施自 2023 年 4 月 6 日起施行，有效期 5 年，实施期间如遇国家及省、市有关政策规定调整的，可进行相应调整。本措施由深圳市光明区工业和信息化局负责解释。

公开属性：主动公开

深圳市光明区人民政府办公室

2023 年 3 月 27 日印发
